

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位及人员	中邮证券-吴文吉 方正富邦-巩显峰 锦绣中和-徐界 鹏扬基金-孙碧莹 东吴基金-张浩佳 山西证券-高宇洋 中泰证券-李雪峰 中信建投-张思颜 兴银基金-陈宇翔 东方基金-梁忻 广发基金-陈宇庭 民生电子-李萌 融通基金-陈甲诚 光大保德信-魏晓雪 中金基金-汪洋 富国基金-王亮 国投证券-马良 东兴资本-刘辉	富业盛德-吴亚林 聚铭资管-惠博文 华宝基金-曹旭辰 国联电子-王海 合众资管-张看 中科沃土-黄艺明 翀云资管-余海海 鸿德资管-郭航 创金合信-王先伟 长盛资管-钱文礼 信达澳亚-冯明远 中意资管-臧怡 和谐健康保险-朱之轩 长城财富-胡纪元 中邮证券-万玮 长城证券-邹兰兰 民生证券-曾竹溪
时间	2024年8月	
地点	电话会议	

接待人员	总经理袁欣女士、董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>业绩情况：</p> <p>今年上半年，公司继续保持年初以来的上升趋势。受半导体行业周期回暖的带动，公司订单有所增加，报告期内实现营业收入1.25亿元，相比去年同期增加约59%。</p> <p>三大主营业务简要分析：</p> <p>首先，大直径硅材料实现营业收入8,039.78万元，毛利率约为58%；</p> <p>第二，硅零部件产品整体收入受到国产设备技术提升、产品迭代的带动，出现了大幅度增长，报告期内实现营业收入约3,658万元，这个数字已经接近了该业务去年全年收入——3,764万。在收入大幅增长的条件下，毛利率仍继续保持去年全年水平。半年收入基本达到去年全年的水平，说明该业务已经成为公司新的业绩增长点，一定程度上提高了公司业绩的稳定性；</p> <p>第三，半导体大尺寸硅片业务，仍处于工艺优化和客户认证的阶段，所以尚未能够实现单独的盈利。</p> <p>综上，公司在报告期内取得归属于上市公司股东的净利润476万元，相比业绩预告略高，实现了扭亏为盈。</p> <p>公司本期整体业绩有两大特点：</p> <p>第一，公司收入，拆分到各项业务、各个区域之间，分布得更为均衡，公司业绩稳定性有所改善；</p> <p>第二，公司在中国本土半导体供应链里的位置更加稳固，相应的融合程度也更高。</p> <p>市场环境：</p> <p>2024年上半年，智能手机和个人电脑等主力消费电子产品销量有相对比较温和的回升，生成式人工智能应用对终端AI服务器所需高端芯片的拉动明显。公司处于半导体行业的上游材料端，终端产品的销售情况，其影响最终会经过一段时间传导到公司。因此，公司密切关注终端产品的销售情况，以分析未来需求情况。</p> <p>一方面，经过接近两年的库存消耗，消费电子产品库存有一定的改善；但是</p>

受制于通货膨胀，以及地缘政治的影响，尚未看到整体消费者信心有强劲回升。从主力消费电子产品的回暖情况来看，可能还没有达到足以促成一个非常大的上行趋势的地步。

另一方面，以ChatGPT为代表，生成式人工智能对下游高性能的逻辑和存储芯片的带动明显；但是，从短期的数据来分析，暂时还未能代替消费电子产品对集成电路产品需求的整体拉动。目前，集成电路制造厂以及一些互联网龙头企业，还在通过大量的资本开支和研发投入，去购买更大的算力和存储的能力来支撑产品和服务的创新。但是，大众消费的下一个引爆点在哪里？下一轮景气周期是否已经明确地开启？针对这两个问题，在不久以前，美国资本市场存在一定的观点分歧，引发了龙头企业股票价格的波动。

总结：上游的集成电路制造和设备，以及公司所在的材料领域，因为下游应用的不同，受到的影响是结构性的、阶段性的，还没有达到普遍较高景气的程度。

根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)2024年6月发布的数据，预计2024年全球半导体市场将同比增长16.0%，其中逻辑芯片市场增长10.7%，存储芯片市场增长76.8%。WSTS预计2025年全球半导体市场将同比增长12.5%，其中逻辑芯片市场增长10.0%以上，存储芯片市场增长25.0%以上。

由以上数据可见，全球半导体产业结构性、阶段性的特征还是比较明确的，因此公司对未来市场持谨慎乐观的态度。

未来计划：

大直径材料业务，根据直接客户的订单数量结合行业的需求增速，公司会按计划扩充产能，基于前述“谨慎乐观”的态度，公司未来会实施针对性、策略性的产能扩张。

硅零部件业务，随着国内半导体行业设备、材料国产化的数量增加和质量提升，需求可观。因此，公司未来会继续在泉州和锦州两大生产基地扩大生产规模，确保能够满足现有客户的需求。

8英寸硅片方面，今年公司还是保持“守势”，持续提升生产工艺和良率的稳定性，兼顾验证评估需求跟公司经济效益的最佳产量平衡，优化排产计划。

综上，公司三块业务，有的将保持进攻态势扩大战果，有的要坚守阵地减少

损失，争取在2024年实现让广大投资者满意的业绩。

问答环节：

一、公司毛利率水平恢复原因

因为2023年公司整体收入只有1.35个亿，其中大直径硅材料业务收入下滑明显，造成边际成本增加；此外，硅片业务仍处于开拓阶段，成本较高，对公司整体毛利率影响很大。

今年以来，毛利率恢复最主要的原因还是大直径硅材料业务重拾动能，出货量和销售额有所增加，边际成本降低；除了收入端的恢复以外，原材料成本也有所改善；

加之硅零部件业务的快速增长，毛利较高，相应地提升了公司整体毛利率。

硅片方面，公司采取了诸多措施，兼顾认证评估和经济效益的平衡，成本有所减少。

综上这些因素，公司上半年的毛利率有所提升。

二、硅零部件业务的发展前景

硅零部件增长态势很好，并且与半导体国产自主直接相关。公司的策略是减少低毛利产品的生产占比，尽量去做难度高、技术门槛高、毛利率高的产品，解决国内厂商的“卡脖子”问题，与国产设备商共同研发高端机台所需部件。虽然这类业务的需求量未必特别大，但是毛利率比较可观。这与公司大直径硅材料业务的基本思想一脉相承——尽量去做盈利性更强的产品。公司未来争取硅零部件毛利率保持平稳，继而做大整体销售收入规模，这在当下内卷严重的市场环境下是较为稳健的选择。

三、轻掺硅片验证进度以及硅片业务对报表的影响

公司硅片业务目前处于“战略防守”的态势。根据行业惯例，正片的送样过程至少要经过12到18个月，同时目前市场竞争也相对比较激烈，公司目前有若干款硅片产品处于送样认证过程中，相关情况请查阅公司公告。2024年，硅片业务预计仍将继续处于防守态势，兼顾验证评估需求跟公司经济效益的最佳产量平衡，优化排产计划，目标是减少亏损。

四、结合原始多晶硅等原材料变化，公司未来整体毛利率展望

毛利率大概可以从两个角度去分析：收入端和成本端。收入端，截止目前，

	<p>公司大直径硅材料产品尚不存在明显的价格调整；成本端，原始多晶硅原料是刻蚀用硅材料最主要的原材料，公司已经开始在市场上采购原始多晶硅。由于当前原始多晶硅的市场价格相比公司库存价格更为有利，公司原材料成本改善的效果未来会逐渐体现。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月